

京セラ サマーインターンシップ募集要項

京セラでは、自身の将来のキャリアについて考えたい、仕事の適性を知るため就業体験してみたい、という学生の皆様のご要望にお応えして技術系職種の内定インターンシップを実施致します。このインターンシップを通じて、私たち京セラのダイナミックな事業活動やビジネスマインドを体感していただけることを願っています。

応募資格	大学3年生 または 修士1年生(技術系専攻の方)
募集職種	技術部門 詳細は「募集職種リスト」をご覧ください。
実習地	神奈川／大阪／滋賀／鹿児島 ほか 詳細は「募集職種リスト」をご覧ください。
時期	8月20日(月)～、8月21日(火)～、9月3日(月)～、9月4日(火)～ (期間: 1週間または2週間) 職種により、開始日・期間は異なります。詳細は「募集職種リスト」でご確認下さい。
実習時間	9:30～17:30 または 8:45～16:45 うち休憩1時間 (時間帯は実習地ごとに異なります。)
待遇	交通費 : 自宅または宿泊施設から職場までの通勤実費を支給致します。 日当 : 昼食代として1,000円/日(出勤日のみ)を支給致します。 宿泊施設 : 自宅からの通勤が困難な方には、宿泊施設を提供致します。 (宿泊施設までの旅費支給あり。)
注意点	実習いただく際は、所定のインターンシップ賠償保険に加入いただきます。 また、インターンシップ応募にあたりご提出いただいた書類は返却致しません。 悪しからずご了承願います。

応募・選考	(1)まずは、日経ナビ2009でログインIDを取得して下さい。 (2)同封の「応募用紙」に必要事項ご記入の上、ご郵送下さい。書類選考の上、面接をご案内いたします。 ※「応募用紙」の受付には日経ナビ2009 ログインIDが必要です。 日経ナビ2009URL : http://job.nikkei.co.jp/ ※選考結果は合否に関わらず全員にご連絡致します。
書類送付先	〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 京セラ株式会社 人事企画部 人材開発課 サマーインターンシップ係

7月5日(木)消印有効

京セラ株式会社 人事企画部 人材開発課 サマーインターンシップ担当:中平/大西
直通TEL : 075-604-3510
E-MAIL : saiyou@kyocera.jp

京セラ サマーインターンシップ 募集職種リスト

下記の部門でインターンシップへ参加いただける方を募集致します。

それぞれご希望部門の実習地・応募資格をよくお確かめの上で所定の「応募用紙」にてご応募下さい。

選考の上、結果につきましては全員にご連絡致します。

【技術部門】

応募No.	募集職種	実習地	期間	日数	学年		インターンシップ内容	応募要件	希望専攻
					大学3年	修士1年			
A-1	ファインセラミックス(評価)	国分工場(鹿児島)	8/21~	10日間	○	○	構造用セラミック材料の評価。	化学・物理に関する知識、セラミックに興味を持った方歓迎。	材料工学・化学
A-2	切削工具開発(生産技術)	川内工場(鹿児島)	8/20~	5日間	○	○	生産工程の改善業務、Cpk(工程能力)・系統図使用による品質改善業務	一般的な工学部としてのスキルをお持ちの方、または切削加工分野へ興味をお持ちの方歓迎。	機械工学・材料工学・薄膜工学
A-3	切削工具開発(製造・評価測定)	川内工場(鹿児島)	8/20~	10日間	○	○	切削工具材料の製造実習(セラミック材料・コーティング)、切削工具と切削性能の関連性評価実習。	セラミック材料・機械加工・金属加工に関する知識をお持ちの方、または切削加工分野へ興味をお持ちの方歓迎。	材料工学・物質工学・薄膜工学
A-4	切削工具開発(製造・評価測定)	八日市工場(滋賀)	9/3~	10日間	○	○	切削工具と切削性能の関連性評価実習(旋削用工具、転削用工具など)。	機械加工・金属加工に関する知識をお持ちの方、または切削加工分野へ興味をお持ちの方歓迎。	機械工学・設計工学・切削加工
A-5	半導体部品(微細加工)	国分工場(鹿児島)	9/4~	5日間	○	○	配線パターン微細加工実習。	半導体部品関連に興味のある方。	理工学系
A-6	半導体部品(設計・シミュレーション)	国分工場(鹿児島)	9/4~	5日間	○	○	高周波設計・シミュレーション実習。	高周波関連に興味のある方。	電気・電子工学
A-7	半導体部品(評価・分析)	国分工場(鹿児島)	8/21~	5日間	○	○	メッキ皮膜特性の評価・分析。	理工学専攻で、表面工学のスキルをお持ちの方、またはメッキに興味を持っていただける方。	理工学系
A-8	半導体部品(構造設計)	蒲生工場(滋賀)	9/3~	5日間	○	○	セラミックと金属の接合体の構造設計。	材料力学の基礎知識をお持ちの方歓迎。	機械工学
A-9	生産技術	大阪玉造事業所(大阪)	8/20~	5日間	○	○	分散技術または粘弾性技術、及び、電子部品の評価。	ものづくりに興味を持っている方で、有機化学物質の一般知識をお持ちの方、EXCELの一般的なスキルをお持ちの方歓迎。	化学系
A-10	通信機器(シミュレーション)	横浜事業所(神奈川)	8/20~	10日間	-	○	無線通信のシミュレーション及びその結果のデータ分析。	無線通信に興味があり、関連科目を履修した方歓迎。	情報通信工学・無線通信工学
A-11	通信機器(評価)	横浜事業所(神奈川)	8/20~	5日間	○	○	携帯電話のデバイス、及び、回路評価。	電子回路の基礎知識を有する方歓迎。	電気・電子工学
A-12	通信機器(評価)	横浜事業所(神奈川)	9/3~	5日間	○	○	携帯電話のソフトウェア評価。	情報工学の基礎知識を有している方、プログラミング経験のある方歓迎。	情報工学
A-13	通信機器(試作組み立て)	横浜事業所(神奈川)	9/3~	5日間	○	○	携帯電話の機構信頼性評価、及び、試作組み立て実習。	機械力学、材料力学の基礎知識を有している方歓迎。	機械工学
A-14	電子部品(設計・試作測定)	国分工場(鹿児島)	9/4~	5日間	○	○	セラミック材料を使用した分布定数回路によるフィルター素子設計と試作測定及び製造工程実習。	電子・電気回路、材料工学等に興味がある方歓迎。	特になし
A-15	電子部品(評価測定)	国分工場(鹿児島)	9/4~	5日間	○	○	積層セラミックコンデンサの電気特性及び測定技術。	アナログ回路、電気回路に関する知識のある方歓迎。	工学部系
A-16	薄膜部品(プロセス技術)	筆人工場(鹿児島)	8/20~	5日間	○	○	サーマルプリントヘッド(薄膜部品)の製造工程、あるいは、そのプロセス技術支援実習。	クリーンルーム、薄膜加工についての知見がある方歓迎。	理工学系(電気電子、物理、化学)
A-17	自動車部品(データ分析・プロセス分析)	国分工場(鹿児島)	8/21~	10日間	○	○	グローブプラグ関連のデータ分析、及び、工程のプロセス分析実習。	明るくやる気のある人で、機械工学、冶金、無機化学に関する知識のある方歓迎。	特になし
A-18	自動車部品(プロセス分析・評価)	国分工場(鹿児島)	8/21~	10日間	○	○	ピエゾアクチュエータの製造プロセス分析、及び、ベルチェモジュールの評価実習。	物理、化学、材料工学、機械工学に関する知識のある方歓迎。	特になし
A-19	部品研究(解析技術開発)	国分総合研究所(鹿児島)	8/21~	10日間	-	○	異種材料接着構造体における接着部の寿命推定評価技術に関する研究。	物理、化学、力学、材料力学、破壊力学、材料工学に関する知識のある方で、機械的実験、シミュレーションなどに興味を持っている方歓迎。	物理系、機械系

※募集は各職種1名ないしは2名です。

2007年 サマーインターンシップ応募用紙

日経ナビ
応募ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年 月 日記入

フリガナ		生年月日		
氏名		19 年 月 日		
		(歳)		
学校名	大学 学部 学科 年 大学院 研究科 専攻 年			
E-Mail				
現住所	〒 -			
	電話（自宅） - -			
	電話（携帯） - -			
帰省先	〒 -			
	電話番号 - -			
保有資格	語学 TOEIC 点、TOEFL 点 その他			
	クラブ活動			
所属ゼミ (研究室)	指導教官			
ゼミ（研究室）での研究内容（専門分野）				

写真貼付

①縦4cm×横3cm
②写真裏面に氏名
記入

第1希望	応募No.		応募職種名		実習地	
第2希望	応募No.		応募職種名		実習地	

京セラのインターンシップへ参加する理由

応募職種の選択理由と裏づけとなる保有知識や技術

(2 / 2 枚目)

【記入上の注意】

- ・ 字数制限はありません。自由にお書き下さい。枠をオーバーする場合や補足資料のある場合は別紙にて同封下さい。
- ・ ペンまたはボールペンにて記入して下さい。(鉛筆書き不可)
- ・ 応募用紙は全2枚です。